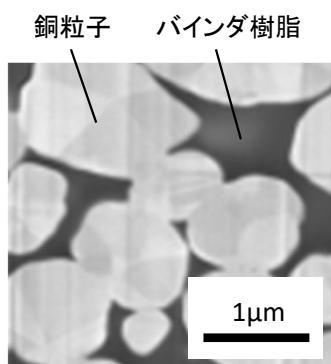


## はんだ対応 銅ペースト ELTRACE® CP-901AN

ELTRACE® CP-901ANは、優れた焼結性、熱伝導性および、はんだ濡れ性を示すことを特長とするスクリーン印刷対応の窒素下硬化型銅ペーストです。銅ペースト配線上への電子部品のはんだ実装が可能なため、銅箔の代替品としてご使用いただけます。

### 特長① 焼結性

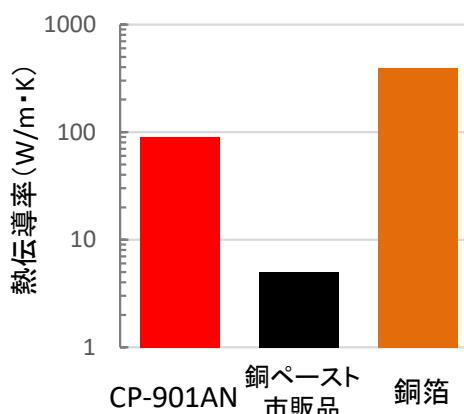
CP-901ANは窒素下250°C以上 の加熱で、銅粒子同士の焼結が 進行します。このため、導電性、 熱伝導性に優れます。



銅ペースト硬化膜の断面SEM像

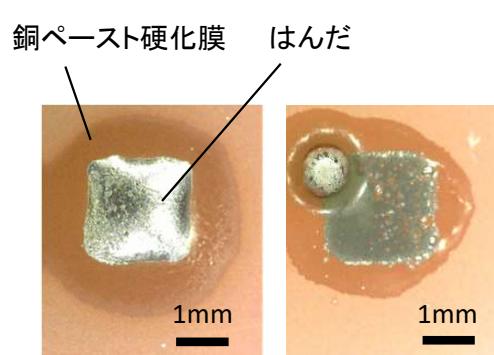
### 特長② 熱伝導性

CP-901ANから得られる硬化膜は、 優れた熱伝導性を示します。放熱性 を重視する電子部品の接合に好適 です。



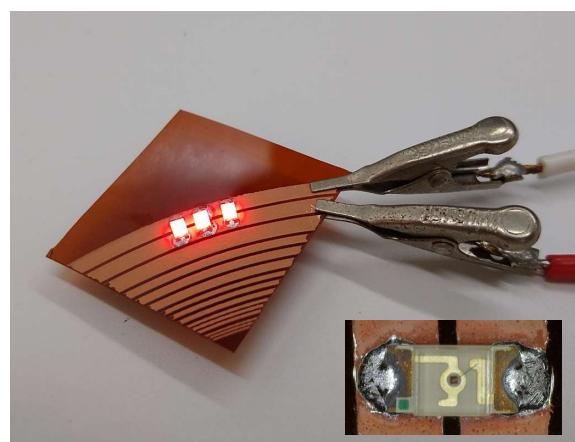
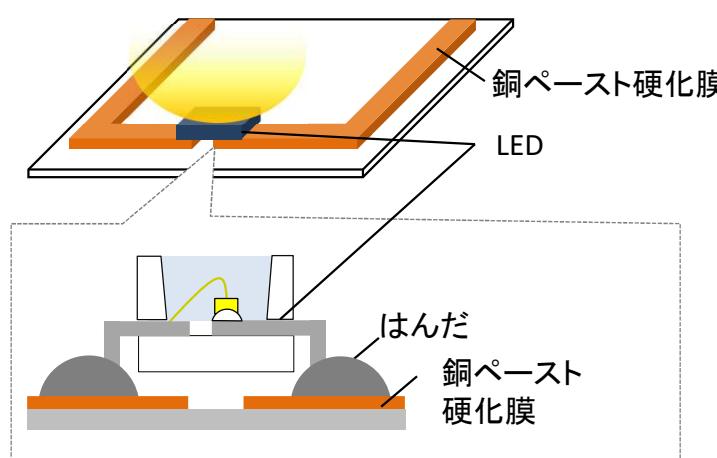
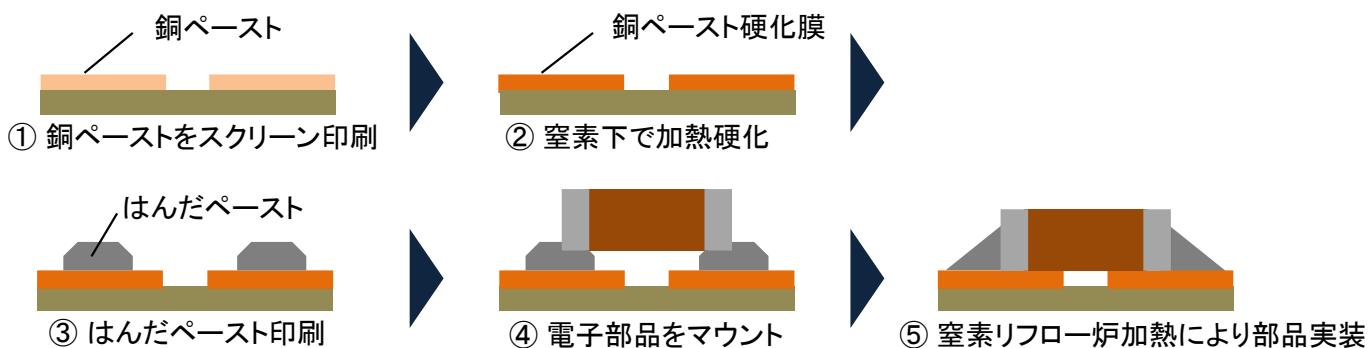
### 特長③ はんだ濡れ性

CP-901ANから得られる硬化膜は、 はんだ濡れ性が良好です。 銅ペースト硬化膜上への電子部品 のはんだ実装が可能です。



CP-901AN 当社従来品

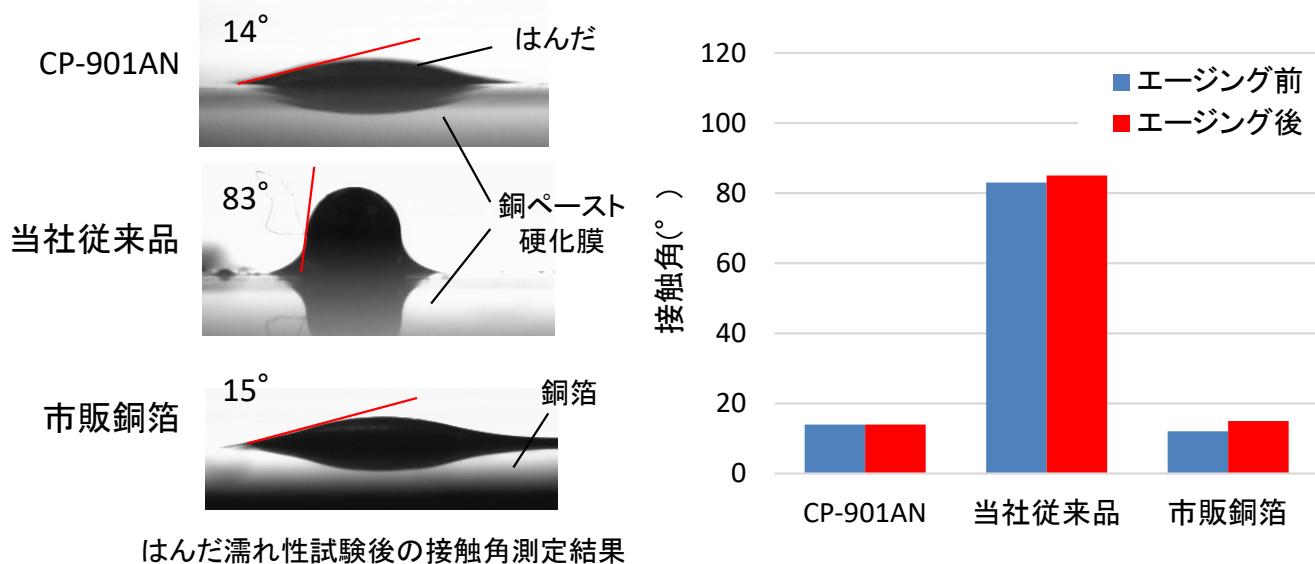
## 銅ペーストの使用例



LEDデバイス作製例

# はんだ濡れ性

ELTRACE® CP-901ANは、150°C × 16時間のエージング処理後も、市販の銅箔と同等のはんだ濡れ性を示します。



## 一般特性

項目	試験条件	測定値
粘度	E型粘度計、25°C、5rpm	10～50 Pa·s
体積抵抗率	推奨硬化条件 250°C × 15min(N <sub>2</sub> ) 300°C × 15min(N <sub>2</sub> ) 350°C × 15min(N <sub>2</sub> )	10 μΩ·cm 7 μΩ·cm 5 μΩ·cm
はんだ接合強度	スタッドピン垂直引張試験 はんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu	5 MPa
熱伝導率	周期加熱法、厚み方向	80～100 W/m·K

## 耐久性

項目	試験条件	結果
耐高温高湿性	85 °C × 85 %RH × 1,000 h	
耐熱性	128 °C × 240 h	体積抵抗率変化 <10%
耐冷熱衝撃性	-40 °C, 1 min ⇄ 100 °C, 2min, 2,000 cycle	剥離無し
耐マイグレーション	85 °C × 85 %RH × DC50 V 1,000 h L/S: 318/318 (μm)	短絡無し

記載内容は現時点での入手できた資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価、危険・有害性等に関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、記載事項は通常の取扱いを対象としたものでありますので、特別な取扱いをする場合は用途、用法に適した安全対策を実施のうえ、お取扱いください。

ELTRACE、エルトレースは日油株式会社の登録商標です。